

平成 16 年 4 月に年産 5 5 0 万㎡へ 「エスパネックス」の生産能力を大幅に増強

当社（社長：西 恒美）電子材料事業部は、回路基板材料事業の主力商品であるフレキシブルプリント基板用無接着剤銅張積層板（2層CCL）「商品名：エスパネックス」につきまして、現在、平成16年2月の営業運転開始を目処に、木更津製造所（千葉県）の生産能力を年産400万㎡とする増強工事を進めておりますが、今回、さらに約20億円を投資して、平成16年4月の営業運転開始を目処に、年産550万㎡とする増強工事に着手いたしました。

能力増強の背景

ここ数年2層CCLは、携帯電話を中心とするデジタル機器の小型軽量化、高性能化に伴う回路基板の高密度実装化、微細加工に不可欠な材料として需要が拡大を続けており、特に昨年春から携帯電話の高機能化（カメラ搭載、動画化対応等）や画面の高精彩化により市場が急速に拡大しております。

こうしたなか、品質・性能に優れる当社材料「エスパネックス」へ需要が集中しており、相次ぐ能力増強（ ）にも、その需要に一部対応出来ない状況となっていることに加え、携帯電話の高機能化・高精彩化は、日本国内にとどまらず韓国、中国、欧州等、世界的な広がりを見せており、2層CCL市場の拡大は確実と予想されることから、今回さらなる能力増強に着手したものです。

年産能力の推移

平成元年～	「エスパネックス」販売開始	
～平成14年5月	第二系列まで稼働	120万㎡/年
平成14年6月	第三系列営業運転開始	180万㎡/年
平成15年5月		300万㎡/年（新硬化プロセス稼働）
平成16年2月	第四系列営業運転開始	400万㎡/年
平成16年4月	第五系列営業運転開始	550万㎡/年

エスパネックスの特徴と新商品について

当社の2層CCL「エスパネックス」は、当社の基盤技術である高分子技術であるベ-スとした特殊ポリイミド樹脂を利用し、高性能回路基板市場をターゲットに事業を展開しており、微細加工に必要な「寸法安定性」「銅箔接着力の信頼性」「絶縁性」「回路加工性」に優れております。また、最近の携帯電話で主流となっている折り畳み式携帯電話端末のヒンジ（折り曲げ）部に要求される「耐屈曲性」にも優れるなど、2層CCLの分野では、事実上の標準材料となっており、その品質優位性から、世界シェアの60%～70%を有する商品となっています。

さらに今般、回路基板のファインピッチ化、高密度化がいつそう進展する中で、かねてより顧客から強い要請のあった湿度寸法変化率の低減（寸法精度向上）を実現する新製品「エスパネックス-Mシリーズ」の開発に成功いたしました。開発された新商品は、低吸湿性と寸法安定性に優れた新規ポリイミド樹脂の特性を生かしたもので、顧客の要求を満足する高度な品質特性を実現するなど、高い評価を得たことから、この5月より稼働を開始した新硬化プロセスで製造する主力商品として、市場へ投入いたしました。

今後の動向について

パソコン用液晶画面、液晶テレビ、プラズマディスプレイ、有機ELといったフラットパネルディスプレイ向けをはじめ、デジタルカメラ、DVDなど、「エスパネックス」は携帯電話向け以外にも用途が着実に拡大しており、さらに需要の伸長に拍車がかかるものと予測されることから、今後の需給動向に応じて年産700万㎡～800万㎡への増強を視野に入れた検討を進めてまいります。

また、今後の設備増強にあたっては、需要地での立地や生産拠点の分散などの観点から、海外も含めた新たな立地についての検討も進めてまいります。

当社電子材料事業部では、現在主力となっています回路基板材料「エスパネックス」をはじめ、有機EL材料や液晶関連材料などの「フラットパネルディスプレイ材料」、次世代型実装材料や絶縁材料など「半導体関連材料」をラインナップしており、これらトータルで3～5年後に約300億円の事業規模を目指してまいります。